PAT-NO:

JP02004194046A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004194046 A

TITLE:

CRYSTAL RESONATOR AND CRYSTAL OSCILLATOR USING

IT

PUBN-DATE:

July 8, 2004

INVENTOR - INFORMATION:

COUNTRY

WATANABE, MAKOTO

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

NIPPON DEMPA KOGYO CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP2002360561

APPL-DATE: December 12, 2002

INT-CL (IPC): H03H009/19, H03B005/32, H03H009/02

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a crystal resonator for which vibration

characteristics are excellent and a crystal oscillator accelerating miniaturization.

SOLUTION: In the crystal resonator composed of a crystal piece provided with

a stress relaxation groove on the outer peripheral part of a vibration area,

the groove is turned to first and second double grooves provided on the inner

and outer sides and the vibration area is surrounded by the double

Also, the crystal piece where an extraction electrode is extended on mutually

opposing surfaces by an electrode through-hole provided on the outer periphery

of the double groove from the excitation electrode of the vibration area, a

semiconductor element having a crystal terminal connected to the extraction

electrode on one main surface and an external terminal on the other main

surface, for which an oscillation circuit is integrated, and a cover are

provided. The crystal piece, the semiconductor element and the cover are

provided with a gap and the outer periphery is sealed with a sealing member.

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO&NCIPI

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特別2004-194046 (P2004-194046A)

(43) 公開日 平成16年7月8日 (2004.7.8)

(51) Int.Cl. ⁷		Fı			テーマコード(参考)
нозн	9/19	нозн	9/19	В	5J079
нозв	5/32	нозв	5/32	Н	5J108
нозн	9/02	нозн	9/02	K	

		審理	2請求	未請求	請求項	気の数 2	2 OL	, (全 ——	5 頁)		
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-360561 (P2002-360561) 平成14年12月12日 (2002.12.12)	(71) 出願人 000232483 日本電波工業株式会社 東京都渋谷区西原 1 丁目 2 1 番 2 号									
`.	•	(72) 発明者 渡辺 誠 埼玉県狭山市大字上広瀬1275番地の2 日本電波工業株 式会社狭山事業所内									
		F & - 1	、(参	考)5J079 5J108	HA16 HA16 AA06 EE07 KK01	BA43 HA28 BB02 FF07 KK07	BA44 HA29 CC04 GG03	HA04 CC09 JJ01	HA07 EE03 JJ04		

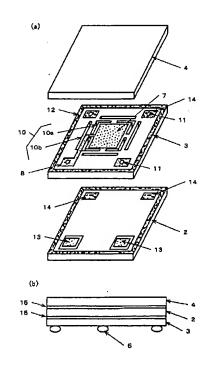
(54) 【発明の名称】水晶振動子及びこれを用いた水晶発振器

(57)【要約】

【目的】本発明は振動特性を良好とした水晶振動子及び 小型化を促進する水晶発振器を提供する。

【構成】振動領域の外周部に応力緩和の溝を設けた水晶 片からなる水晶振動子において、前記溝は内外に設けた 第1と第2の二重溝とし、前記振動領域を前記二重溝に よって包囲した構成とする。また、前記振動領域の励振 電極から前記二重溝の外周に設けた電極貫通孔によって 互いに反対面に引出電極を延出した水晶片と、前記引出 電極と接続する水晶端子を一主面に有して外部端子を他 主面に有するとともに発振回路を集積化した半導体素子 と、カバーとを備え、前記水晶片と前記半導体素子及び 前記カバーとに間隙を設けて外周をシーリング部材によ って封止した構成とする。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

振動領域の外周部に応力緩和の溝を設けた水晶片からなる水晶振動子において、前記溝は内外に設けた第1と第2の二重溝とし、前記振動領域を前記二重溝によって包囲したことを特徴とする水晶振動子。

【請求項2】

前記振動領域の励振電極から前記二重溝の外周に設けた電極貫通孔によって互いに反対面に引出電極を延出した水晶片と、前記引出電極と接続する水晶端子を一主面に有して外部端子を他主面に有するとともに発振回路を集積化した半導体素子と、カバーとを備え、前記水晶片と前記半導体素子及び前記カバーとに間隙を設けて外周をシーリング部材によって封止したことを特徴とする水晶発振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は水晶振動子及びこれを用いた水晶発振器を産業上の技術分野とし、特に小型化を促進する水晶発振器に関する。

[0002]

【従来の技術】

(発明の背景)水晶発振器は周波数や時間の基準源として電子機器に広く用いられている。近年では、さらなる小型化が求められ対応が模索されている。

[0003]

(従来技術の一例)第3図は一従来例を説明する図で、同図(a)は水晶発振器の断面図、同図(b)は水晶片の図である。

水晶発振器は凹状とした実装基板1に半導体素子(ICチップ)3と水晶片2を収容し、カバー4を被せて密閉封入してなる。実装基板1は表面実装用の外部端子5を有する。半導体素子3は発振回路を集積化し、実装基板1の凹部底面にバンプ6を用いた超音波熱圧着によって固着される。水晶片2は両主面に励振電極7を有し、一端部両側に一対の引出電極8を延出する。各引出電極8は互いに反対面に折り返して形成される。そして、一端部両側を凹部の段部に導電性接着割9によって固着してなる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

(従来技術の問題点)しかしながら、上記構成の水晶発振器では半導体素子3と水晶片2とが実装基板1内に別個に固着されるため、構造上、小型化が困難となる。また、水晶片2も小さくなるので振動特性を確保することが困難な問題があった。

[0005]

(発明の目的) 本発明は振動特性を良好とした水晶振動子及び小型化を促進する水晶発振器を提供することを目的とする。

[0006]

【特許文献1】特開2001-28516号公報

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1では、振動領域の外周部に設けた応力緩和の溝は内外に設けた第1と第2の二重溝とし、前記振動領域を前記二重溝によって包囲する。したがって、例えば全周を固着(保持)したとしても、全周に溝が設けられているので振動領域に発生する応力が軽減され、振動特性を維持する。

[0008]

本発明の請求項2では、前記振動領域の励振電極から前記二重溝の外周に設けた電極貫通 孔によって互いに反対面に引出電極を延出した水晶片と、前記引出電極と接続する水晶端 子を一主面に有して外部端子を他主面に有するとともに発振回路を集積化した半導体素子 と、カバーとを備える。そして、前記水晶片と前記半導体素子及び前記カバーとに間隙を 10

20

30

50

40

設けて外周をシーリング部材によって封止する。

[0009]

この構成であれば、水晶片に電極貫通孔を設けて引出電極を両主面に設けるので、外周を 封止できる。そして、水晶片の両主面に電気的に接続した半導体素子とカバーを接合する ので、水晶発振器の高さ寸法を小さくできる。以下、本発明の一実施例を説明する。

[0010]

【実施例】

第1図は本発明の一実施例を説明する図で、同図 (a) は水晶発振器の分解図、同図 (b) は同正面図である。

水晶発振器は水晶片2と半導体素子3とカバー4とからなる。水晶片2は略正方形状とし、中央部を振動領域として両主面に励振電極7を有する。振動領域の外周には、内外に設けた第1と第2の溝10(ab)の二重溝10を有する。第1溝10aは励振電極7の4角部に鉤状に、第2溝10bは4辺に平行に形成される。要するに、二重溝10は振動領域(励振電極7)を包囲して形成される。

[0011]

励振電極7からは二重溝10の間を経て一端部両側に引出電極8が延出し、さらに電極貫通孔11によって互いに反対面に延出する。また、両主面の外周には接合用の環状電極12が形成され、他端部両側に電極貫通孔11を有するアース電極14が形成される。

[0012]

半導体素子3は発振回路を集積化し、一主面側を基準電位面ここではアース電位面とする。そして、特許文献1で示されるように一主面の一端部両側に水晶端子13を他端部両側にアース電極14を、他主面に図示しない電源、出力及びアース端子等の外部端子を有する。

[0013]

なお、一主面のアース電位面はアース端子に電気的に接続する。アース端子はそして、各外部端子には実装端子 5 としての例えば半田ボールが接続する。また、一主面の外周には接合用の環状電極 1 2 が形成される。カバー 4 は金属又は導電性を有する材料からなる。

[0014]

このようなものでは、引出電極 8 の延出した水晶片 2 の一端部両側と半導体素子 3 の水晶端子 1 3 とを、両者のアース電極 1 4 とを、また外周に設けた両者の環状電極 1 2 とを、及び水晶片 2 とカバー 4 とを位置決めして積層する。但し、水晶片 2 、半導体素子 3 及びカバー 4 との当接面間には水晶の転移点温度 573℃以下の接合金属 1 5 例えば A u S nからなる共晶合金を介在させる。そして、共晶合金を溶融して接合し、封止する。

[0015]

このような構成であれば、水晶片 2 の一端部両側に電極貫通孔 1 1 を設けて同一主面に引出電極 8 を延出し、外周に環状電極 1 2 を形成する。そして、半導体素子 3 を実装基板 1 として兼用し、水晶片 2 とカバー 4 を積層して封止するので、基本的に高さ寸法を小さくできる。なお、接合金属 1 5 の厚みによって振動領域との間にギャップが形成され、振動が維持される。

[0016]

また、水晶片 2 は二重溝 1 0 によって振動領域が包囲されるので、全方向からの応力を緩和する。したがって、水晶片 2 の全周が半導体素子 3 及びカバー 4 に固着しても、振動領域に与える影響を小さくして振動特性を良好にする。そして、この実施例ではカバー 4 を金属として半導体素子 3 のアース電位面(一主面側)に電気的に接続するので、カバー 4 を接地できてシールド効果を奏する。

[0017]

【他の事項】

上記実施例では水晶片 2 と半導体素子 3 及びカバー 4 とは環状電極 1 2 に共晶合金を設けて接合したが、環状電極は除去して低融点ガラスや樹脂によって封止してもよい。この場合、カバー 4 はセラミック等の絶縁材としてもよい。要するに、水晶片 2 、半導体素子 3

40

10

20

30

[@@``@``@` •V•* •N□•X□== @@``@``@`@

及びカバー4との外周をシーリング部材によって封止すればよい。

[0018]

また、引出電極 8 を水晶片 2 の一辺側に延出したが、一組の対角部に延出してもよい。この場合、他組の対角部にアース電極 1 4 を形成する。そして、これに応答して半導体素子 3 の一主面に水晶端子 1 3 及びアース電極を形成する。

[0019]

また、水晶発振器として説明したが、水晶片2は任意な保持手段によって水晶振動子としても利用できる。例えば凹状とした実装基板の底面に水晶片2の外周を固着して封止して水晶振動子とすることもできる。また、振動領域は矩形状としたが、円形状としてもよく任意に形成できる。

[0020]

【発明の効果】

本発明は、振動領域の外周部に設けた応力緩和の溝は内外に設けた第1と第2の二重溝とし、前記振動領域を前記二重溝によって包囲するので、振動特性を良好とした水晶振動子を提供できる。そして、前記振動領域の励振電極から前記二重溝の外周に設けた電極貫通孔によって互いに反対面に引出電極を延出した水晶片と、前記引出電極と接続する水晶端子を一主面に有して外部端子を他主面に有するとともに発振回路を集積化した半導体素子と、カバーとを備え、前記水晶片と前記半導体素子及び前記カバーとに間隙を設けて外周をシーリング部材によって封止するので、振動特性を維持して小型化を促進する水晶発振器を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を説明する図で、同図 (a) は水晶発振器の分解図、同図 (b) は同正面図である。

【図2】本発明の一実施例を説明する水晶振動子の平面図である。

【図3】従来例を説明する図で、同図(a)は水晶振動子の断面図、同図(b)は水晶片の平面図である。

【符号の説明】

1 実装基板、2 水晶片、3 半導体素子、4 カバー、5 実装端子、6バンプ、7 励振電極、8 引出電極、9 導電性接着剤、10 二重溝、11 貫通孔、12 環状電極、13 水晶端子、14 アース電極、15 接合金属.

20

10

30

